

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年12月20日(2007.12.20)

【公開番号】特開2005-142572(P2005-142572A)

【公開日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【年通号数】公開・登録公報2005-021

【出願番号】特願2004-322683(P2004-322683)

【国際特許分類】

H 05 K	1/03	(2006.01)
C 08 K	3/00	(2006.01)
C 08 L	27/12	(2006.01)
C 08 L	79/08	(2006.01)
H 01 L	21/60	(2006.01)

【F I】

H 05 K	1/03	6 1 0 N
H 05 K	1/03	6 1 0 S
C 08 K	3/00	
C 08 L	27/12	
C 08 L	79/08	A
H 01 L	21/60	3 1 1 W

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月2日(2007.11.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

単独でまたは多層構造の成分として電子用途または電気用途に有用である单一層基板であって、单一層基板は少なくともポリイミド成分およびフルオロポリマー成分のポリマーブレンドを含み、

a. フルオロポリマー成分は、

i. 0.02ミクロンと5ミクロンの間の範囲内(両端を含む)の平均粒径を有するフルオロポリマー微細粉末から誘導され、

ii. 375 以下の融解温度を有し、

iii. フルオロポリマー成分は、100重量部のポリイミド成分当たり、9および120重量部の間の範囲内(両端を含む)で存在し、

b. 単一層基板は外側表面と内部コアとを有し、外側表面は、内部コア中に存在するフルオロポリマー成分の量よりも多い量のフルオロポリマー成分を含み、内部コアは、外側表面中に存在するポリイミド成分の量よりも多い量のポリイミド成分を含み、

c. 10ミクロンと200ミクロンの間の範囲内(両端を含む)の総厚を有することを特徴とする单一層基板。